

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2017-069

## 广东超华科技股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重大事项提示：

以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，具体如下：

### 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

#### （一）主要假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行方案于 2017 年 11 月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、根据公司年报，2016 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,193.43 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-7,248.75 万元。考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2017 年公司整体收益情况较难预测，因此假设 2017 年度净利润和扣非净利润按与 2016 年度持平、较 2016 年度减亏 50%、与 2015 年度持平和较 2015 年度增长 100% 分别测算。

4、假设本次非公开发行募集资金总额为上限 88,330.00 万元（包含发行费用），本次发行数量为不超过 18,600 万股。

5、除投入用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。

6、在预测公司 2017 年净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

7、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

8、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年的盈利预测，亦不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

单位：元

项目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	931,643,744	931,643,744	1,117,643,744
<b>情形 1:2017 年净利润与 2016 年净利润持平</b>			

期末归属于母公司股东的净资产	1,675,977,200.23	1,614,042,894.36	2,497,342,894.36
每股净资产	1.7989	1.7325	2.2345
归属于上市公司股东的净利润	-61,934,305.87	-61,934,305.87	-61,934,305.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,487,450.18	-72,487,450.18	-72,487,450.18
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益前）	-0.0665	-0.0665	-0.0654
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后）	-0.0778	-0.0778	-0.0765
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益前）	-3.63%	-3.76%	-3.60%
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后）	-4.25%	-4.41%	-4.22%
<b>情形 2:2017 年净利润较 2016 年减亏 50%</b>			
期末归属于母公司股东的净资产（元）	1,675,977,200.23	1,645,010,047.30	2,528,310,047.30
每股净资产（元）	1.7989	1.7657	2.2622
归属于上市公司股东的净利润	-61,934,305.87	-30,967,152.94	-30,967,152.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,487,450.18	-36,243,725.09	-36,243,725.09
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益前）	-0.0665	-0.0332	-0.0327
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后）	-0.0778	-0.0389	-0.0383
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益前）	-3.63%	-1.86%	-1.79%
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后）	-4.25%	-2.18%	-2.09%
<b>情形 3:2017 年净利润与 2015 年净利润持平</b>			
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	1,675,977,200.23	1,701,961,338.47	2,585,261,338.47
每股净资产（元）	1.7989	1.8268	2.3131
归属于上市公司股东的净利润	-61,934,305.87	25,984,138.24	25,984,138.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,487,450.18	8,724,286.94	8,724,286.94

基本每股收益（元） （扣除非经常性损益前）	-0.0665	0.0279	0.0274
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后）	-0.0778	0.0094	0.0092
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益前）	-3.63%	1.54%	1.47%
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后）	-4.25%	0.52%	0.49%
<b>情形 4:2017 年净利润较 2015 年净利润增长 100%</b>			
期末归属于母公司股东的净资产（万元）	1,675,977,200.23	1,727,945,476.71	2,611,245,476.71
每股净资产（元）	1.7989	1.8547	2.3364
归属于上市公司股东的净利润	-61,934,305.87	51,968,276.48	51,968,276.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,487,450.18	17,448,573.88	17,448,573.88
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益前）	-0.0665	0.0558	0.0549
基本每股收益（元） （扣除非经常性损益后）	-0.0778	0.0187	0.0184
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益前）	-3.63%	3.05%	2.93%
加权平均净资产收益率 （扣除非经常性损益后）	-4.25%	1.03%	0.98%

注 1：（1）本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；

（2）本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

（3）本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2—本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；

（4）本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2—本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

（5）2016 年期末归属于母公司股东的所有者权益（预计）=期初归属于母公司股东的

所有者权益-本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润+本次股权融资额。

注 2：上述测算中，每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定进行了计算。公司对 2016 年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

由上表可以看出，与发行前相比，公司非公开发行完成后的净资产总额及每股净资产规模将大幅增加，资产规模和资金实力将得到增强。但由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期，短期内公司每股收益和净资产收益率会有所下降。未来，随着募集资金投资项目效益逐渐释放，预计公司净利润将实现增长，公司盈利能力将进一步提高，公司每股收益和净资产收益率也将相应增加。

## 二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债率将进一步降低并且资产结构将更利于公司发展战略的实施，公司整体实力将得到增强，有助于增强公司资金实力、抗风险能力和持续融资能力，帮助公司未来通过各种融资渠道获取低成本资金，加强整体竞争力以实现公司的战略目标。由于募集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标相比于发行前将出现一定幅度的下降。

公司提醒投资者，上述分析不构成公司的盈利预测，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间均存在不确定性。一旦前述分析假设条件或公司经营发生重大变化，不排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

## 三、公司本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等要求，公司制定并持续完善了《广东超华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金

的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：

1、公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。

2、公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。

3、公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。公司的募集资金原则上应当用于主营业务。

公司改变发行申请文件中所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。

4、公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

5、公司应当在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况。

6、公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；公司当年存在募集资金运用的，董事会应当对半年度和年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并聘请注册会计师对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

7、保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查；保荐机构在对上市公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在

重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。

8、公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或募集资金用于收购资产的，至少应在相关资产权属变更后的连续三期的年度报告中披露该资产运行情况及相关承诺履行情况。

#### 四、董事会选择本次融资的必要性和合理性

公司拟通过本次非公开发行，募集资金投入年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产 600 万张高端芯板项目、年产 700 万平方米 FCCL 项目的建设，符合公司“纵向一体化”拓展上游高端原材料的战略，有利于增强公司盈利能力及丰富产品多样性，更好满足客户需求，进一步提高公司市场竞争优势，是公司可持续发展的重要举措。

##### （一）本次非公开发行的必要性

##### 1、发掘可持续盈利增长点，提高公司盈利能力

公司主要从事 PCB、CCL 及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。公司是 PCB 行业中少数具有垂直一体化产业链的制造型企业之一，目前公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，并为客户提供“一站式”产品服务。

近年中国经济处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整还在持续，经济运行仍比较困难，加之世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，且经济运行中的不确定因素在增加。传统印制电路板行业景气度下滑，企业产能过剩，竞争愈发激烈，转型压力日益剧增。但是在常规产品竞争激烈的同时，汽车电子、互联网应用产品及新能源汽车等迅速崛起，给上游电子元器件和材料产业又带来了新的春风。

2015 年公司调整了发展战略，坚持“纵向一体化”产业链发展的同时，向上游原材料产业领域拓展，本次非公开发行股票募集资金的投资方向包括：年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产 600 万张高端芯板项目和年产 700 万平方米 FCCL 项目，是公司发展战略的延续。随着公司向上游原材料市场拓展，

将进一步提高公司的盈利空间。此外本次非公开募投项目均为行业内前沿技术，保障了公司的可持续发展能力。

## 2、增强公司产品多样性

公司在 PCB 行业深耕细作多年，在铜箔基板、铜箔、单/双面覆铜板、双面多层印制电路板等领域有较深厚的积累及市场地位，但总体来说，公司业务主要集中在刚性板领域，以单/双面板及多层板为主。本次非公开发行募投项目中的 FCCL、FR-4 薄板及高频覆铜板是公司原有业务的重要补充，同时公司多年来通过内外结合的研发方式，在锂电铜箔及高频覆铜板领域已经有一定的技术积累，本次募投项目的实施也是公司将前期研发投入转化为利润的重要举措。

### (二) 本次非公开发行的合理性

#### 1、政策鼓励发展高密度印刷电路板和挠性板

PCB 是现代电子设备中必不可少的基础组件，是各种电子整机产品的重要组成部分，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义，因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对 PCB 行业进行扶持和鼓励，其中主要集中在高密度印刷电路板和挠性板的推动上，具体政策如下表：

时间	文件名称	发布单位	具体内容
2010年10月18日	《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。
2011年6月23日	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》	国家发改委、科技委、工业和信息化部、商务部和知识产权局	优先发展新型元器件中包括高端混合集成电路和高频器件，高密度多层印刷电路板和柔性电路板。
2013年2月16日	《产业结构调整指导目录(2011	国家发改委	鼓励类中包括：新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力

	年本)2013 年修改版》		电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造。
2015年3月10日	《外商投资产业指导目录(2015年修订)》	国家发改委、商务部	将“高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板”列入鼓励外商投资产业目录。
2015年3月6日	《2015年工业强基专项行动实施方案》	工信部	关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向,提升材料保障能力。

## 2、FPC 及 HDI 成为 PCB 行业增长主要动力

FPC 及 HDI 主要应用于包括智能手机在内的移动智能终端市场。以手机为代表的移动智能终端市场规模、发展趋势、出货量直接决定了 FPC 及 HDI 产品的市场需求。市场调研公司 IDC 报告显示,2016 年全球智能手机出货量为 14.71 亿部,年增长 2.32%,其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和 VIVO,国产手机厂商已经在全球五强中位居三强。

表: 2016 年全球市场智能手机销售情况

序号	品牌	2016 年出货量(亿台)	2015 年出货量(亿台)	出货量变化(%)	市场份额变化(%)	2016 年市场份额(%)	2015 年市场份额(%)
1	三星	3.11	3.21	-2.96	-5.16	21.18	22.33
2	苹果	2.15	2.32	-6.95	-9.07	14.65	16.11
3	华为	1.39	1.07	30.19	27.23	9.47	7.45
4	OPPO	0.99	0.43	132.79	127.50	6.76	2.97
5	VIVO	0.77	0.38	103.42	98.80	5.26	2.64
6	其他	6.28	6.97	-9.94	-11.99	42.69	48.50
合计		14.71	14.37	2.32	-	100.00	100.00

数据来源: IDC

2016 年全年,中国市场智能手机销量共 4.67 亿部,同比增长 8.7%,该增幅高于全球同期水平,也远高于 2015 年 1.6%的增长率。OPPO、华为、VIVO 成为中国智能手机市场全年出货量前三,超过了苹果和三星,小米在国内销量超过了三星位居第五。

表：2016 年中国市场智能手机销售情况

序号	品牌	2016 年出货量（千万台）	2015 年出货量（千万台）	出货量变化（%）	2016 年市场份额（%）	2015 年市场份额（%）
1	OPPO	7.84	3.53	122.10	16.78	8.21
2	华为	7.66	6.29	21.78	16.39	14.63
3	VIVO	6.92	3.51	97.15	14.81	8.16
4	苹果	4.49	5.84	-23.12	9.61	13.58
5	小米	4.15	6.49	-36.06	8.88	15.10
6	其他	15.67	17.33	-9.58	33.53	40.31
合计		<b>46.73</b>	<b>42.99</b>	<b>8.70</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

数据来源：IDC

根据科技行业分析公司 Linley Group 发布的最新报告显示，到 2020 年，全球使用的物联网设备将达到 19 亿个。这些接入设备包括仪器、汽车、摄像头、智能手机、可穿戴产品及其他。

随着下游智能终端对性能及轻薄程度的要求越来越高，对 FPC 及 HDI 的需求量也越来越高，据电子行业咨询机构 Prismark 姜旭高博士在 2017 年 3 月“CPCA 春季论坛”作的报告，2016-2021 年 HDI 板和挠性板（包括刚挠结合板）的年复合增长率超过传统 PCB 产品，分别为 2.8% 和 3.0%。

### 3、电子设备高频化成为未来发展趋势

随着信息技术的革命，数字电路逐渐步入信息处理高速化、信号传输高频化阶段，为处理不断增加的数据，电子设备的频率变得越来越高，这时基板的性能将严重影响数字电路的特性，因此相关下游行业对 PCB 基板性能提出了新的要求。电子设备高频化的原因主要包括以下三点：

（1）随着我国通信业的快速发展，原有的民用通信频段已经出现拥挤，我国部分军事用途的频段逐渐对民用开放，目前高频通信已经广泛应用于卫星接收、基站、导航、医疗、运输、仓储等领域。

（2）高质量信号传输的需求，使移动电话、汽车电话及无线通信向高频化发展。

(3) 计算机技术处理能力的增加，信息存储容量的增大，迫切要求信号传送高速化。

高频覆铜板主要解决普通覆铜板在通信中微波及毫米波等领域传输性能不稳定及损耗大的高频特性缺陷，是高频印制电路板的核心原材料。高频印制电路板应用领域如下表：

应用领域	适用频段
个人接收基地台或卫星发射	13-24Ghz
汽车防碰撞系统	75Ghz
直播卫星系统	13Ghz
卫星降频器	2-3Ghz
家庭接收卫星	12-14Ghz
全球卫星定位系统（GPS）	1.57/1.22Ghz
汽车、个人接收卫星	2.4Ghz
天线携带通信天线系统	14Ghz
卫星小型地面站	12-145Ghz
数字微波系统	10-38Ghz

#### 4、新能源汽车发展带动锂电铜箔需求

铜箔是一种特殊电解材料，具体为粘合于电路板基板上的一层薄的铜金属箔。主要应用于电路导通、电磁屏蔽及抗静电，具有优良的导通性，并提供电磁屏蔽的效果。铜箔的应用范围非常广泛，电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等新兴领域也离不开铜箔这一基础材料。

随着环境污染问题日益显著，政策鼓励环保、促进节能减排的政策趋势越来越明确，其中新能源汽车则是其中重要的组成部分。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。

高工产研锂电研究所（GGII）预测，受新能源汽车市场驱动，2017-2020年锂电铜箔的总需求量分别可达5.42万吨、6.65万吨、8.68万吨、11.42万吨，年

复合增速约 28.2%。而锂电铜箔供给端存量产能严重不足，增量供给提升缓慢，供求两端存在巨大缺口。

综上所述，随着锂电铜箔需求快速增长，我国锂电铜箔市场将出现产能缺口，为行业内锂电铜箔生产企业带来更大的利润空间。

## 五、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

### （一）本次募投项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用于年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产 600 万张高端芯板、年产 700 万平方米 FCCL 项目的建设。本次募投项目的实施是公司往上游高端原材料行业延伸战略布局的一部分，除锂电铜箔外，本次募投项目新增的产品均为 PCB 行业的重要上游高端原材料。而锂电铜箔是铜箔领域的一个细分行业，公司拥有多年铜箔制造的经验及技术积累，是公司做专做精，往细分领域渗透的必然选择。

### （二）公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

#### 1、人员储备

公司在 PCB 行业深耕细作多年，已经形成了完善的人才培养体系，经过多年的发展，公司成功培育出了一批实际与理论结合的复合型技术人才。同时公司管理层拥有多年的企业经营、生产管理、技术开发、市场推广的经验，其中公司总工程师周佩君先生于 2015 年 3 月当选为中国印制电路板行业协会专用材料分会副会长。公司在研发及市场推广上已经有良好的人才储备，满足项目实施的需求。

#### 2、技术储备

公司积极推进新技术和新产品的研发工作，紧追行业领先技术，以超薄电子铜箔、特种绝缘纸、高频/高速电路板及覆铜箔板、挠性线路板等电子基材系列产品及其加工新技术与装备研发为主题，与企业目前生产紧密结合，提高公司产品生产技术水平 and 产品层次，强化核心技术，提高公司核心竞争能力。

2016年6月，公司与哈尔滨理工大学材料科学与工程学院签订了《校企产学研合作协议书》，有利于促进公司科技创新，充分利用高等院校的技术、人力资源以及先进的成熟技术成果，与公司的生产条件结合，将科研成果尽快转换为生产力，更有利于公司储备科研人才；同时，公司与哈尔滨理工大学签订了《技术开发（委托）合同》，研发高频覆铜板相关技术，哈尔滨理工大学为公司高频覆铜板产业提供科研和技术支持，帮助公司解决高频覆铜板产业发展的技术、工艺问题，有利于提升公司覆铜板产业的技术水平。

公司前次募集资金投资建设的研发中心建设项目，已成为公司发展的新引擎。公司通过加强与高校和科研院所的合作力度，加速促进产学研合作，扩展产品线，孵化新产品、新技术，寻求变革机遇。

### 3、市场储备

公司凭借稳定的产品质量、准时的交货期，继续强化市场营销推广，深挖已有市场资源，与骨干客户飞利浦、美的空调、欧普光电、松下、立讯精密、依顿、宏仁、胜宏科技、奥斯康等多个国内外知名企业深度的战略合作。

同时，由于本次募集资金投资项目所生产产品具有较高的技术壁垒，市场需求量较大，公司在前期与潜在客户沟通过程中已经达成部分合作意向，本次募投项目有较好的市场储备基础。

综上所述，公司在PCB及铜箔行业具有较强的人员、技术及市场积累，具备实施本次募集资金投资项目的的能力。

## 六、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

### （一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

#### 1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略，并持续向上游原材料产业拓展，目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板专用木浆纸、钻孔及压合加工在内的全

产业链产品线的生产和服务能力，为客户提供“一站式”产品服务。实施“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，加大产品生产、销售及新产品研发力度，实现营业收入和利润的稳步增长；借助资本市场的先发优势，以内生发展结合外延并购的方式，择机收购兼并行业内优质企业，完善产品线，延伸“纵向一体化”产业链布局，并逐步实现在全国电子基材行业的平台布局，使之成为中国最具规模的电路解决方案提供商之一。

近年来，智能终端和触控产品的发展带动了 HDI 板的发展，高阶 HDI 设计及应用成为小型化、高精密化和多功能化消费电子产品（以智能手机、平板电脑和超级本等为代表）的主流。此外，随着智能手机、数码相机、高清电视（HD-TV）和其他数据处理产品中 FPC 的应用越来越广泛，挠性电路板产品在近年持续保持高速增长。随着下游电子系统产品更新换代，HDI 板及挠性电路板用量扩大这一趋势预计将保持延续。

电子信息产品更新换代，智能手机、平板电脑需求旺盛，推动 PCB 产业快速成长，PCB 下游电子信息产业良好的发展势头是 PCB 产业成长的基础。根据我国工信部发布的《2016 年电子信息制造业运行情况》显示，我国电子信息产业规模稳步扩大，2016 年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%，增速比上年回落 0.5 个百分点，快于全部规模以上工业增速 4 个百分点，占规模以上工业增加值比重提高到 7.5%。同时，我国主要电子信息产品产量稳步增长：

**通信设备行业生产保持较快增长。**生产移动通信基站设备 34,084 万信道，同比增长 11.1%。出口交货值同比增长 3.4%。

**计算机行业生产延续萎缩态势。**全年生产微型计算机设备 29,009 万台，下降 7.7%。出口交货值同比下降 5.4%。

**家用视听行业生产增速同比加快。**全年生产彩色电视机 15,770 万台，同比增长 8.9%，其中液晶电视机 15,714 万台，增长 9.2%；智能电视 9,310 万台，增长 11.1%，占彩电产量比重为 59.0%。出口交货值同比增长 1.8%。

**电子元件行业生产稳中有升。**全年生产电子元件 37,455 亿只，同比增长 9.3%。出口交货值同比增长 2.6%。

**电子器件行业生产平稳增长。**全年生产集成电路 1,318 亿块，同比增长 21.2%；半导体分立器件 6,433 亿只，增长 11%。光伏电池 7,681 万千瓦，同比增长 17.8%。出口交货值同比下降 0.7%。

PCB 在移动互联网终端产品、智能手机的广泛应用，使致力于移动通讯和无线数据传输的 PCB 生产厂家大幅受益；另一方面，PCB 在汽车电子领域的应用也越来越广，如在汽车上集成了移动通信、电脑、储存和无线网络等多种电子产品的智能汽车管理系统、汽车多媒体交互系统等，这给 PCB 应用市场发展提供了新的机遇。

未来 PCB 产品将持续向高密度化、高频化、高速数字化和多功能化方向发展，对 PCB 原料 CCL、电子铜箔、专用木浆纸、玻纤布等产品的技术及质量要求也将提升。此外，由于绿色环保概念在业内已成为共识，全球印刷线路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更严格和迫切，环保型印刷线路板亦将是未来印刷线路板企业的主要发展方向。

综上，新一代信息技术正在步入加速成长期，带动产业格局深刻变革，新消费热点使 PCB 行业面临更为广阔的市场空间和需求规模。未来企业要大幅提升生态建设及环保能力，要从规模增长型转变至质量改进型，最后再向创新福利型迈进，以建设新型经济体系及福利社会为目标。

## 2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

### (1) 市场风险

#### ①利率风险

因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### ②其他价格风险

公司生产所需主要原材料多种，原材料上涨时，公司可以提高产品售价，原材料下跌时，公司将降低产品售价。因此，在产能和销售量确定的情况下，公司存在主要原材料价格波动导致公司营业收入波动的风险。在原材料价格大幅度上涨时，公司通过调高销售价格尽可能降低价格波动对公司销售的影响。

## （2）信用风险

2016年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

## （3）流动风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## （二）全面推行精细化管理，以实现降本增效

公司着重以降本增效为核心，全面推行精细化管理。一是全面执行预算管理，围绕年初目标任务，扎实做好各项预算指标的细化分解，防范资金风险，有效盘活存量资金；二是在各事业部推行独立核算制度，通过确立与市场挂钩的部门核算制度、培养具有经营者意识的人才和实现全员共同参与经营的理念，突破现有管理瓶颈，提升业绩；三是健全绩效激励机制，完善重点岗位目标任务和责任制落实考核体系；四是降低各项物耗、能耗，降低成本，提高利润率；五是不断完善内部控制，通过健全各项内控制度，加强过程监控有效地规避了经营风险。

## （三）加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将不断

优化业务结构，继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

#### **（四）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用**

公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。

同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

#### **（五）优化投资者回报机制**

公司将严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

### **七、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

## **八、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人梁健锋先生、梁俊丰先生，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十一日